

## SC 3001H 涂覆胶

### 产品特点

- 可荧光检测的单组分脱醇型室温固化涂覆胶
- 优异的电气绝缘性能
- 防硫腐蚀性能
- 耐盐雾性能
- 无溶剂，低粘度，涂覆之后可以快速自流平
- 高表面硬度
- 室温快速表干，可加热快速固化
- 对多种基材有很好的粘结性
- 可配合专用稀释剂使用，以适应各种工况
- 通过 RoHS 环保认证与 UL94 V-0 认证

### 产品用途

WANICONE® SC 3001H 广泛用于电子组装工业。是精密电子部件接口、电路板保护硅胶的最佳选择。

- 电路板涂覆
- 精密微电子器件灌封保护

### 性能参数

	项目	指标	单位
固化前	颜色	无色透明	--
	外观	高流动液体	--
	有效成分含量	100	%
	粘度 (25°C)	480	mPa s
	表干时间 (23°C/50% RH)	25	min
	表干时间 (60°C烘箱)	7	min
	密度	1.10	g/cm <sup>3</sup>
固化后 (23°C/50% RH固化7天)	硬度	80	Shore A
	耐压测试	>1.5	kV
	体积电阻	3×10 <sup>14</sup>	ohm cm
	击穿强度	24	kV/mm
	介电常数 (50Hz)	2.5	--

## 包装规格

采用普通包装为 1kg/罐；5kg/罐；或按照客户指定包装形式。

## 贮存条件和保质期

请储存于阴凉、干燥、通风处。因是与空气中水分发生反应固化，因此在不使用时一定要牢固密封保存。

自生产日期计，未开封的 WANICONE® SC 3001H 在 28℃ 以下的保质期为 9 个月。

## 使用方法

### ➤ 表面处理

基材表面需干燥、清洁，去除锈迹、灰尘和油污等。

### ➤ 施胶

适用于电路板的刷涂、浸涂、喷涂等涂敷方式。涂敷层厚度会影响到对电子线路保护的质量。一般建议涂敷厚度为 >50 微米。

## 使用注意事项

- 如果温度较低，固化时间也会延长。如需加热加速固化，加热温度需要控制在 64℃ 以下。
- 不宜用于密不通风的场，与所有的室温湿气固化一样，需要在使用前以及使用中防止过分暴露于湿气。
- 材料表面低于 4℃ 或超过 50℃ 时，不宜施工。

## 环境健康

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

## 版本信息

TDS 编号：PCS\_3088

发布日期：2020 年 07 月 11 日

版本号：V2.0

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，

我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号 邮 编：264006

客户服务中心咨询电话：+86 (535)-8203244 传真：+86 (535)-3388222-3244

<http://www.whchem.com>

E-mail: [PCS@whchem.com](mailto:PCS@whchem.com)